

WGT

Wir gehen in die Tiefe

Expertenseminar in der Aufbau- und Verbindungstechnologie

26. – 28. September 2023

Expertenseminar in der Aufbau- und Verbindungstechnologie

Sehr geehrte Damen und Herren,

freuen Sie sich auf die Neuauflage der Veranstaltung **Wir gehen in die Tiefe** in Dresden. Wir laden Sie ein, mit uns die neuesten Trends der Branche, in neuem Format zu diskutieren!

Durch den steigenden Anteil von hochsensiblen Bauelementen werden in der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) der Einsatz modernster Technologien sowie immer aufwändiger Prozesse forciert. Hochleistungselektronik für E-Mobility und 5G-Technologie sind nur zwei Beispiele von vielen, die diesen Trend zusätzlich vorantreiben.

Smart Factory, Digitalisierung & Vernetzung, Ressourcenschonung und **Nachhaltigkeit** sind die Schlagworte, welche die Entwicklungen in der Elektronikfertigung bestimmen. So gilt die Energiewende als eines der wichtigsten Zukunftsthemen unserer Wirtschaft – und die Elektronikindustrie liefert als Innovationsmotor die nötigen Technologien und Komponenten.

Mit zwölf Fachvorträgen und dem direkten Erfahrungsaustausch mit hochkarätigen Experten und Kollegen ist die Veranstaltung die optimale Plattform für den Austausch zu diesen aktuellen Themen sowie den Zukunftstechnologien in der Elektronikfertigung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr Veranstalterteam

ASMPT
enabling the digital world

ASYS GROUP

CHRISTIAN KOENEN GMBH
HIGHTECH STENCILS

TCM
THERMAL SYSTEMS

VLIESTOFF KASPER
GMBH

STANNOL
PIONEERS OF SOLDERING

ZEVAC

Organisation, Information und Anmeldung

ASYS Automatisierungssysteme GmbH
Nicole Egle
Benzstrasse 10
89160 Dornstadt

Telefon: +49 7348 9855 5107
E-Mail: nicole.egle@asys-group.com

Veranstaltungsort

mightyTwice Hotel Dresden
Königsbrücker Straße 121a
D-01099 Dresden
<https://www.twicehotels.de/dresden>

Telefon: +49 (0) 351 80 63 0
Fax: +49 (0) 351 80 63 721

PROGRAMM

27. September 2023

08.00 Uhr Einlass | Table Top Ausstellung

09.00 Uhr **Begrüßung und Moderation**

09.15 Uhr **Vollautomatisierte THT-Produktionslinie mit Siplace-Bestückern von ASMLT**
Philipp Fischer, Siemens AG

10.00 Uhr **Nachhaltiges Lackieren – Wo geht die Reise hin?**
Gianfranco Sinistra, Rehm Thermal Systems GmbH

10.45 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr **Lithografie in der Chipfertigung – Was bringt die Zukunft?**
Dr. Florian Schall, Carl Zeiss SMT GmbH

12.00 Uhr Mittagessen | Table Top Ausstellung

13.30 Uhr **Digital Heating – Steigerung von Qualität und Effizienz durch punktgenaue Erwärmung**
Ronald Claus von Nordheim, watttron GmbH

14.15 Uhr **Runter mit der Löttemperatur – wie steht's um die Zuverlässigkeit von NSL-Lötverbindungen?**
David Dudek & Thomas Ahrens, Trainalytics GmbH

15.00 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr **Fortschrittliche Fehleranalyse als Grundlage für zuverlässige Elektronik – durch Ursachenforschung Fertigungsprozesse optimieren**
Helge Schimanski, Fraunhofer ISIT

16.15 Uhr Diskussion | Table Top Ausstellung

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

28. September 2023

08.00 Uhr Einlass | Table Top Ausstellung

09.00 Uhr **Begrüßung und Moderation**

09.15 Uhr **SMD Foliensensoren – The new kind of Sensors**
Eike Wilhelm Kottkamp, accensors GmbH

10.00 Uhr **Wie Sie Fachkräftemangel und Platzproblemen trotzen können – Smarte Konzepte für Ihre Elektronikfertigung**
Oliver Hagemes, Schnaitt GmbH

10.45 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr **Leistungsbaugruppen vs. Miniaturisierung**
Michael Schimpf, ASMLT SMT Solutions

12.00 Uhr Mittagessen | Table Top Ausstellung

13.30 Uhr **Entwicklungstrends von Zusatzwerkstoffen in der AVT**
Jörg Trodler, Trodler-EAVT

14.15 Uhr **Vortragstitel folgt**
N.N., Zevac AG

15.00 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Ende der Veranstaltung

WGT

Wir gehen in die Tiefe